

## 深圳华强实业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**本次担保后，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司累计的对外担保余额为人民币 744,685 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 103.82%。本次担保的被担保人之一圆泰科技有限公司（以下简称“圆泰科技”）资产负债率超过 70%，但圆泰科技是公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

1、担保人：深圳华强实业股份有限公司

2、被担保人：公司全资子公司华强半导体有限公司（以下简称“香港半导体”）及公司控股子公司芯斐电子（香港）有限公司（以下简称“香港芯斐”）、芯斐科技（香港）有限公司（以下简称“芯斐科技”）、圆泰科技。

3、担保基本情况介绍

根据各被担保人（以下统称“联名被担保人”）业务开展的实际需要，公司与南洋商业银行有限公司（以下简称“南洋银行”）签订了《保证函》，为联名被担保人向南洋银行申请总金额不超过 5,000 万美元（折合人民币约为 36,000 万元）的联名授信提供担保（以下称为“本次担保”），担保期限为自担保文件生效之日起至债务履行期届满之日后两年止。

4、联名被担保人相关担保额度审议情况

公司于 2024 年 3 月 14 日召开董事会会议、2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，预计公司和/或控股子公司自 2024 年 4 月 1 日起未来十二个月，为联名被担保人等公司控股子公司中的两家或两家以上的公司向银行申请联名

授信提供人民币 294,120 万元的担保额度（以下称为“预计担保额度”）。该议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

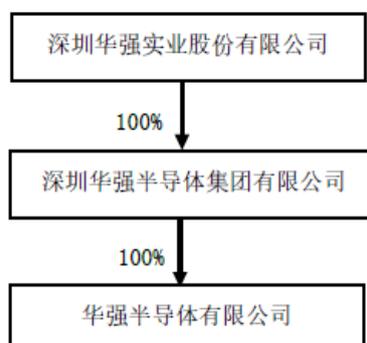
本次担保前公司和/或控股子公司对控股子公司向银行申请联名授信的担保余额为人民币 160,635 万元，可用担保额度为人民币 204,485 万元；本次担保后公司和/或控股子公司对控股子公司向银行申请联名授信的担保余额为人民币 196,635 万元，可用担保额度为人民币 168,485 万元。

本次担保属于公司前述预计担保额度范围内的担保，根据股东大会的授权，公司董事长审批同意了本次担保相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。

## 二、联名被担保人基本情况

### （一）华强半导体有限公司

- 1、名称：华强半导体有限公司
- 2、住所：香港九龙尖沙咀广东道 33 号中港城 1 座 1801B 室
- 3、成立时间：2013 年 11 月 8 日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：陈辉军
- 6、注册资本：6,000 万美元
- 7、与公司关系：香港半导体为公司全资子公司，与公司关系结构图如下：



## 8、主要财务指标：

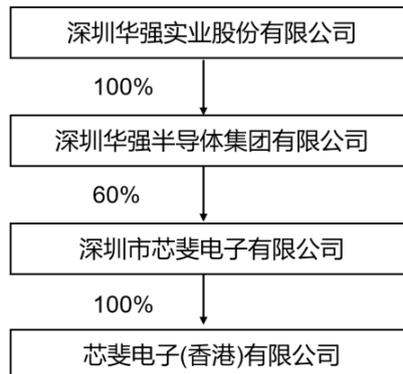
(单位：人民币万元)

项目名称	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	97,332.33	131,969.27
负债总额	58,085.28	98,435.71
其中：银行贷款总额	11,982.01	27,498.42
流动负债总额	58,068.15	98,341.46
归母净资产	37,356.23	33,126.21
或有事项涉及的总额	-	-
	2024年1月至9月(未经审计)	2023年1月至12月(经审计)
营业收入	220,370.24	231,321.62
利润总额	7,268.86	3,159.21
归母净利润	4,648.77	2,654.72

9、香港半导体不是失信被执行人，未受到失信惩戒

### (二) 芯斐电子(香港)有限公司

- 1、名称：芯斐电子(香港)有限公司
- 2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心4楼11室
- 3、成立时间：2015年11月30日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：陈辉军
- 6、注册资本：200万美元
- 7、与公司关系：香港芯斐为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



## 8、主要财务指标：

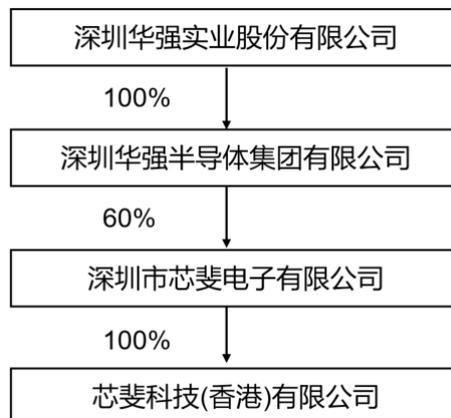
(单位：人民币万元)

项目名称	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	23,069.45	23,533.37
负债总额	15,435.73	15,168.20
其中：银行贷款总额	6,853.19	4,863.87
流动负债总额	15,435.73	15,168.20
归母净资产	7,633.72	8,365.18
或有事项涉及的总额	-	-
	2024年1月至9月(未经审计)	2023年1月至12月(经审计)
营业收入	37,511.94	50,177.29
利润总额	-777.83	609.57
归母净利润	-651.86	508.78

## 9、香港芯斐不是失信被执行人，未受到失信惩戒

### (三) 芯斐科技(香港)有限公司

- 1、名称：芯斐科技(香港)有限公司
- 2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心4楼11室
- 3、成立时间：2015年11月10日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：陈辉军
- 6、注册资本：500万美元
- 7、与公司关系：芯斐科技为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



## 8、主要财务指标：

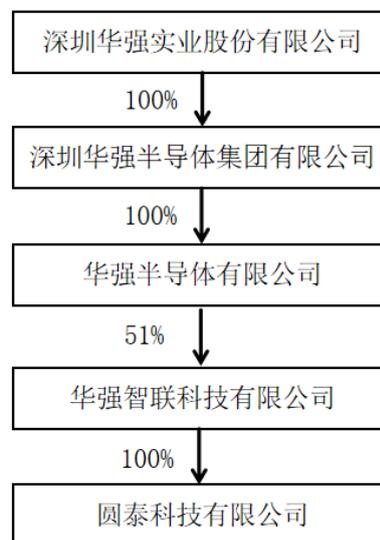
(单位：人民币万元)

项目名称	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	45,070.38	46,266.45
负债总额	20,729.75	23,745.63
其中：银行贷款总额	7,534.89	15,831.70
流动负债总额	20,729.75	23,745.63
归母净资产	24,340.63	22,520.82
或有事项涉及的总额	-	-
	2024年1月至9月(未经审计)	2023年1月至12月(经审计)
营业收入	110,250.24	108,616.72
利润总额	2,502.62	3,187.04
归母净利润	2,089.15	2,660.45

9、芯斐科技不是失信被执行人，未受到失信惩戒

### (四) 圆泰科技有限公司

- 1、名称：圆泰科技有限公司
- 2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心5楼12室
- 3、成立时间：2023年3月29日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：雷波
- 6、注册资本：1,301美元
- 7、与公司关系：圆泰科技为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



## 8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

项目名称	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	21,812.52	2,321.97
负债总额	18,516.06	1,982.33
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	18,516.06	1,982.33
归母净资产	3,296.46	339.64
或有事项涉及的总额	-	-
	2024年1月至9月（未经审计）	2023年1月至12月（经审计）
营业收入	44,758.72	3,639.79
利润总额	3,594.21	404.59
归母净利润	3,002.52	337.91

9、圆泰科技不是失信被执行人，未受到失信惩戒

### 三、担保的主要内容

1、担保事项：为香港半导体、香港芯斐、芯斐科技、圆泰科技共同向南洋银行申请联名授信提供担保，在任一时点，联名被担保人向南洋银行申请贷款或授信的未偿还总金额不得超过 5,000 万美元（折合人民币约为 36,000 万元）。

2、担保方式：连带责任保证担保。

3、担保期限：自担保文件生效之日起至债务履行期届满之日后两年止。

4、担保金额：总金额不超过 5,000 万美元，折合人民币约为 36,000 万元。

5、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：

（1）香港半导体为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况；

（2）公司控制香港芯斐 60%的股权，其他合计控制香港芯斐 40%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额股权质押的方式向公司提供连带责任反担保；

（3）公司控制芯斐科技 60%的股权，其他合计控制芯斐科技 40%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额股权质押的方式向公司提供连带责任反担保；

（4）公司控制圆泰科技 51%的股权，其他合计控制圆泰科技 49%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额保证的方式向公司提供连带责任反担

保。

#### **四、董事会意见**

1、本次担保的被担保人从事的主营业务为电子元器件授权分销，对资金的需求较高，高效、充足的资金保障有助于被担保人开展并进一步开拓业务。在各种融资渠道中，银行融资是一种成本较低的融资方式，通过银行融资获取资金，可以充分发挥公司积累的优质资产和优良信用的无形价值。公司本次为联名被担保人提供担保是为了确保联名被担保人向境内外电子元器件生产商采购的顺利进行，避免因资金规模受限而影响其业务开展和进一步开拓，符合联名被担保人业务经营的实际需要。本次担保的被担保人均为公司全资子公司或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、香港半导体为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况；其余被担保人的其他股东均以最高额股权质押或保证的方式向上市公司提供连带责任反担保。该反担保足以保障上市公司的利益，此次上市公司向被担保人提供担保符合公平、对等的原则，不会损害上市公司及全体股东的利益。

#### **五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保前，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币 708,685 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 98.80%；本次担保后，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币 744,685 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 103.82%，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为人民币 420,017 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 58.56%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日